

Zerstörungsfreie Analytik

Destruktive physikalische Analyse

Thermal Management

Umweltsimulationslabor

Dünnschichtanalyse

Raman Charakterisierung

Elektronik Labor

Phasen-, Morphologie- und Eigenspannungsanalyse

Seminare @ MCL

We Innovate Materials

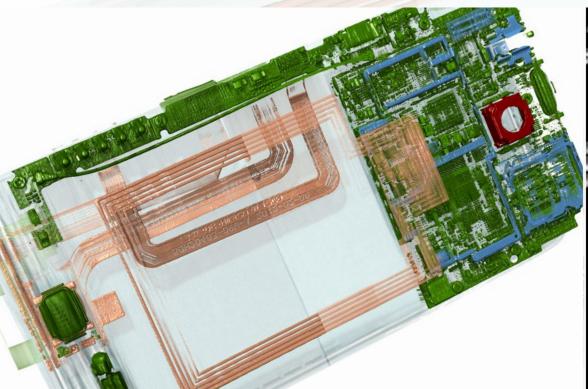
Mikroelektronische Prüfverfahren

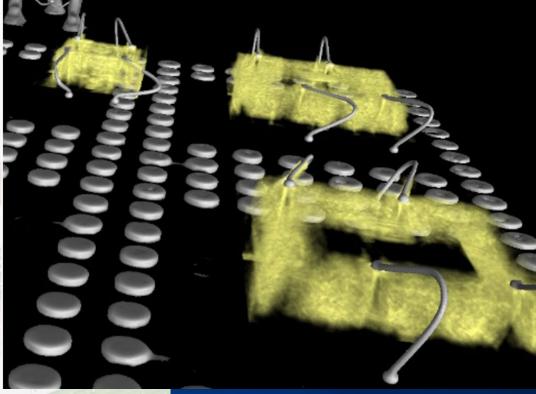




KOMPETENZ & ZUVERLÄSSIGKEIT

Zerstörungsfreie Analytik





Zerstörungsfreie Qualitätssicherung und Fehleranalyse für die Mikroelektronik

Ansprechperson

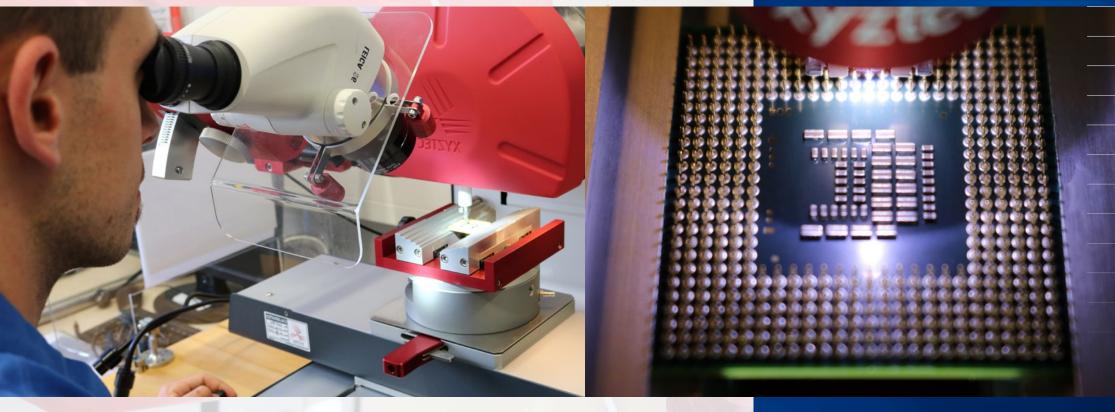


Mag. Jördis Rosc T+43-3842-45922-503

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Fehleranalyse Lokalisierung und Bewertung von Fehlern
- 2D und 3D Porositäts-Analyse
- Erfassung von Geometriedaten
- Soll-Ist-Vergleich
- Texturanalyse Phasen Segmentierung
- In-situ-Prüfung mit mechanischer / thermischer / elektrischer Belastung

Destruktive physikalische Analyse



Zuverlässigkeit von Aufbau und Verbindungstechnologie

Ansprechpersonen



Dr. Barbara Kosednar-Legenstein T+43-676 848883 129

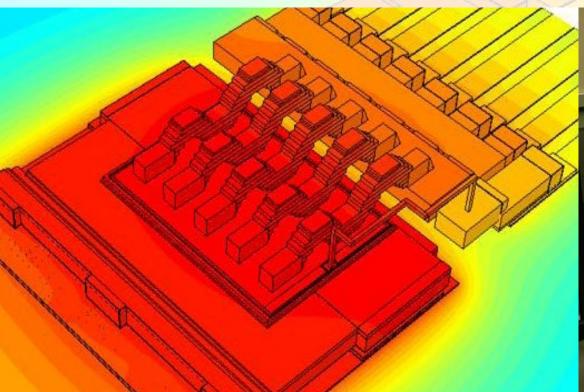


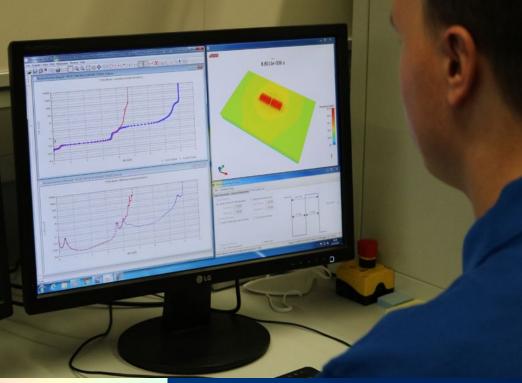
Dr. Julien Magnien T +43-676 848883 203

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Visualisierung von Oberflächenstrukturen
- Erfassung von Geometrie und Mikrostruktur
- Bestimmung von Ausfallmechanismen elektronischer Bauteile (Einschlüsse, Risse, Alterungsprozesse)
- Erfassung von Verformungs-, Schädigungs-, und Bruchverhalten von unterschiedlichen Aufbau- und Verbindungstechnologien
- Bewertung der mechanischen Peel, Scherund Zugbelastung
- 3-Punkt und 4-Punkt Biegebelastung
- Digital Image Correlation (DIC)

Thermal Management





Thermische Analysen vom Material bis hin zu elektronischen Systemen

Ansprechpersonen



Dr. Julien Magnien T +43-676 848883 203

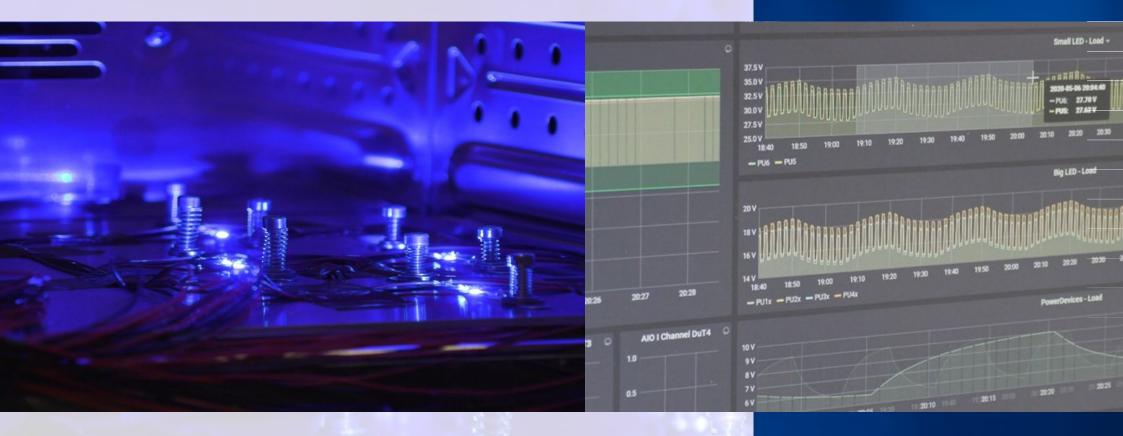


Dr. Lisa Mitterhuber-Gressl T+43-3842-45922-60

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Thermische Widerstand Analyse von Materialien und Systemen (thermische Impedanzanalyse)
- Derating Analysen bis ≤ 160°C
- Wärmepfadanalyse von mikroelektronischen Gehäusen und Systemen
- Bestimmung der thermischen Eigenschaften von dünnen Schichten (Temperaturabhängigkeit) – Temperaturbereich: 20°C bis 500°C
- Bestimmung des thermischen Grenzflächenwiderstands
- Validierte thermische Modelle für Fehleranalysen und Designrichtlinien

Umweltsimulationslabor



Aktive und passive thermische Zuverlässigkeitsprüfung

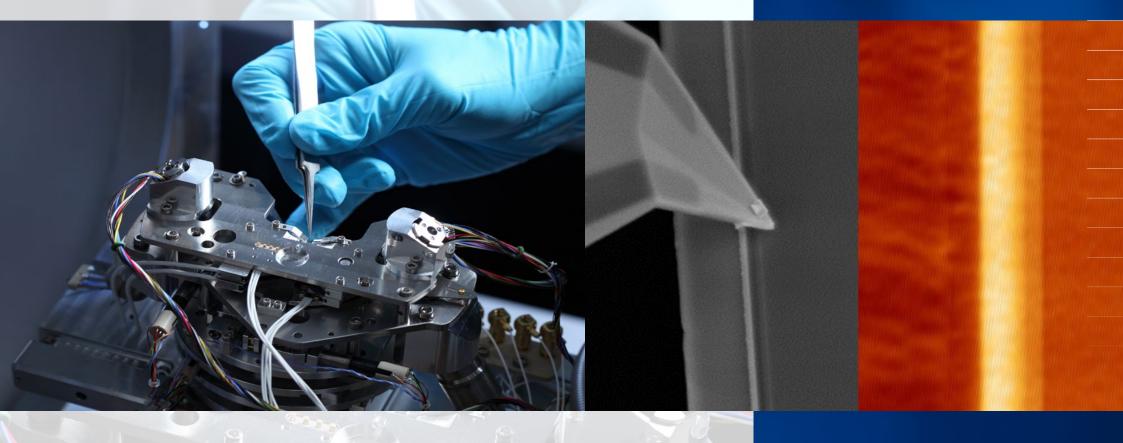
Ansprechperson



Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Temperatur-Schocktest -80°C bis 220°C
- Trocken- und Wärmeschrank bis 300°C
- Wechselklimaschrank -40°C bis 180°C
- Power Cycle Test bis 80 A
- Zustandsüberwachung mittels Temperatur sensitiven elektrischen Parameter (TSEP)
- Datenexploration und -verarbeitung zur Fehlerfrüherkennung und Lebensdauermodellierung

Dünnschichtanalyse



Einzel- und Mehrschicht Systeme im nm bis µm Bereich

Ansprechpersonen



Dr. Julien Magnien T +43-676 848883 203



Dr. Lisa Mitterhuber-Gressl T+43-3842-45922-60

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Scanning Probe Microscopy (SPM) Analysen unter verschiedenen Atmosphären (Ar, N, Vakuum, Luft)
- Topographie und Rauigkeitsanalyse
- Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM)
- Scanning Thermal Microscopy (SThM)
- EBAC (Electron Beam Absorbed Current) / EBIC (Electron Beam Induced Current)

Raman Charakterisierung



Berührungslose Analysemethode zur Materialcharakterisierung

Ansprechperson



Dr. Barbara Kosednar-Legenstein T+43-676 848883 129

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Chemische Zusammensetzung von Materialien
- Kristallinität, Phasenumwandlungen und Phasenzusammensetzungen
- Verunreinigungen und Defekte
- Polarisationsanalyse
- Eigenspannungsanalyse
- Texturanalysen
- Temperaturbereich -196°C bis 600°C

Elektronik Labor



Analyse von funktionalen Materialien bis hin zu elektronischen Systemen

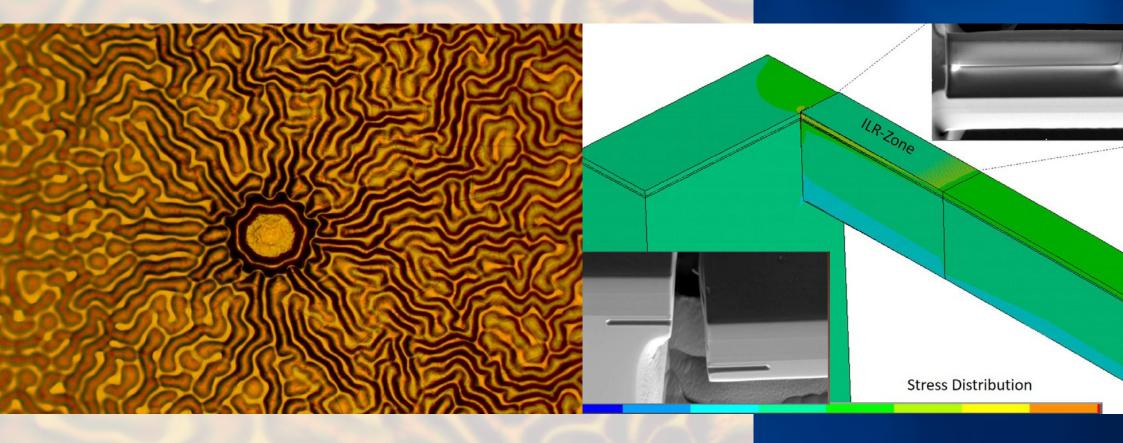
Ansprechperson



Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Statische und dynamische Hystereseanalyse
- Piezoelektrische Analyse
- Durchbruchspannungsanalyse ±1 A (±500 V)
- Strom/Spannungskennlinien
- Frequenzbereich 0.01 Hz bis 150 MHz (2 GSa/s)
- Temperaturbereich -50°C bis 400°C
- Elektrische Impedanzanalyse
- 4-Draht/Punktmessungen

Phasen-, Morphologie- und Eigenspannungsanalyse



Struktur und Morpholgie Einfluss auf Eigenspannungen in Einzelund Mehrschichtsystemen

Ansprechpersonen

Dr. Julien Magnien T +43-676 848883 203



Priv.Doz. Dr. Roland Brunner T+43-676 848883 151

Unsere Schwerpunkte / Kompetenzen

- Hochauflösende EDX & EBSD Analyse im nm Bereich
- Hochauflösende Morphologie Charakterisierung mittels FE-SEM
- Interface & Phasenanalyse
- Lokale Eigenspannungsanalyse mittels IL-R (Ion Layer Removal) Methode



Leistungsangebot

- Analysen von Materialien, Produkten, Prozessfehlern, Leiterplattendefekten und Bauteilausfällen
- Thermische Analyse auf Material- und Systemebene
- Mechanische Prüfung (Zug, Schertest, Nanoindentation, ...)
- Ermittlung von Alterungsphänomenen und -prozessen
- Lokalisierung und Visualisierung von Material- und/ oder Systemfehlern
- Umweltsimulation (TS, TC, PTC, HTOL, ...)
- Dünnschichtanalyse (Materialanalyse und physikalische Eigenschaften)
- Phasen-, Morphologie und Eigenspannungsanalysen
- Systemevaluierung neuer Materialien
- Schadensanalyse
- Seminare und Workshops

Anlagenausstattung

- Computertomograph Nanotom
- SAM 400 (PVA TePla)
- Konfokales UV-Raman Mikroskop alpha300R (Witec)
- Bondtester SigmaCondor (xyzTec)
- μDMA RSA-G2 (TA-Instruments)
- MK56 & 53 Temperaturwechselschränke (Binder)
- Temperaturschock ShockEvent T/60/V2 (Weisstechnik)
- TF Analyzer 3000 (aixACCT Systems)
- TDTR PicoTR (Netzsch)
- Scanning Probe Microscope (Semilab)
- PU / SMU / Frequenzgeneratoren
- Leica TXP EM

